

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第2区分
 【発行日】平成18年12月14日(2006.12.14)

【公開番号】特開2005-136289(P2005-136289A)

【公開日】平成17年5月26日(2005.5.26)

【年通号数】公開・登録公報2005-020

【出願番号】特願2003-372036(P2003-372036)

【国際特許分類】

H 01 L 21/683 (2006.01)

H 01 L 21/677 (2006.01)

B 25 J 15/06 (2006.01)

H 01 L 21/027 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/68 N

H 01 L 21/68 S

B 25 J 15/06 Z

H 01 L 21/30 5 0 2 J

【手続補正書】

【提出日】平成18年10月27日(2006.10.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板の一方の面に吸着する第1保持部と、前記基板の他方の面に当接する第2保持部と、前記第1保持部を前記第2保持部側へ付勢する付勢手段とを有することを特徴とする基板保持機構。

【請求項2】

前記第2保持部を、前記基板を保持する位置と前記基板の保持を解除する位置とに駆動する手段をさらに有することを特徴とする請求項1に記載の基板保持機構。

【請求項3】

前記一方の面が前記基板の上面であり、前記他方の面が前記基板の下面であり、前記基板を下向きに保持することを特徴とする請求項1または2に記載の基板保持機構。

【請求項4】

請求項1～3のいずれか1つに記載の基板保持機構を用いて前記基板としてのレチクルをステージに置き、該レチクルのパターンをウエハに露光することを特徴とする露光装置。

【請求項5】

請求項4に記載の露光装置を用いてウエハを露光する工程と、該露光したウエハを現像する工程とを有することを特徴とするデバイス製造。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 7】

上記の課題を解決するため本発明の基板保持機構は、基板の一方の面に吸着する第1保持部と、前記基板の他方の面に当接する第2保持部と、前記第1保持部を前記第2保持部側へ付勢する付勢手段とを有することを特徴とする。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0008】

本発明によれば、基板の一方の面に吸着する第1保持部と、前記基板の他方の面に当接する第2保持部とにより、基板の両面を同時に保持する。

このため、基板に同時に接触可能な面を増やし、基板の保持力を増加することができ、かつ保持精度を向上させることができる。

その結果、本発明の基板保持機構を適用した露光装置や半導体製造装置などの装置においては、装置全体の基板搬送スループット向上および搬送精度の向上を実現することができる。